VM ㈜

Investor Relations

11. 2026



Disclaimer

본 자료는 기관투자자 및 일반투자자를 대상으로, VM 주식회사(이하 "회사")의 사업 및 재무 등 경영상황에 대한 이해를 돕기 위한 목적으로 작성된 것으로, 회사의 홍보 또는 주식·증권의 매수·매도를 권유하기 위한 자료가 아닙니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과 관련 정보는 일반적으로 인정된 기업회계기준에 따라 작성된 것입니다. 또한 본 자료에는 회사의 향후 경영현황 및 재무실적과 관련된 "예측정보"가 포함되어 있을 수 있습니다. 예측정보란 과거가 아닌 미래의 사건 및 전망과 관련된 정보를 의미하며, '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등의 표현을 포함합니다. 이러한 예측정보는 개별적인 검증 절차를 거치지 않은 것으로, 거시경제 여건·산업 환경·경영전략의 변경 등 다양한 변수에 따라 실제 결과는 예측정보와 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 모든 전망은 작성일 현재 이용 가능한 정보와 시장상황, 회사의 경영방향을 기준으로 한 것이며, 향후 환경 변화 및 회사의 판단에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있습니다.

본 자료는 투자 판단을 위한 참고자료일 뿐이며, 어떠한 경우에도 회사의 주식 또는 기타 유가증권의 모집, 매출, 매매 및 청약을 위한 법적·사실상의 제안이나 권유를 구성하지 않습니다. 또한 본 자료의 그 어느 부분도 관련 계약 체결이나 투자 결정을 위한 기초 또는 근거로 사용될 수 없습니다.

본 자료의 이용 또는 이에 기초한 투자행위로부터 직·간접적으로 발생하는 어떠한 손실에 대하여도 회사 및 회사의 이사, 임직원은 과실 유무를 불문하고 그 책임을 부담하지 않습니다. 모든 투자 결정은 투자자 본인의 책임과 판단에 따라 이루어져야 합니다.

본 자료는 투자자에 대한 정보 제공을 위한 비영리적·내부적 참고용으로만 사용될 수 있으며, 회사의 사전 서면 동의 없이 본 자료의 전부 또는 일부를 임의로 수정·가공하거나 복사·배포·전재하는 행위는 금지됩니다.

CONTENTS

VM Investor Relations 2026

01 회사소개

02 Our Business

03 Our Strength

04 Our Strategy

01 VM Overview

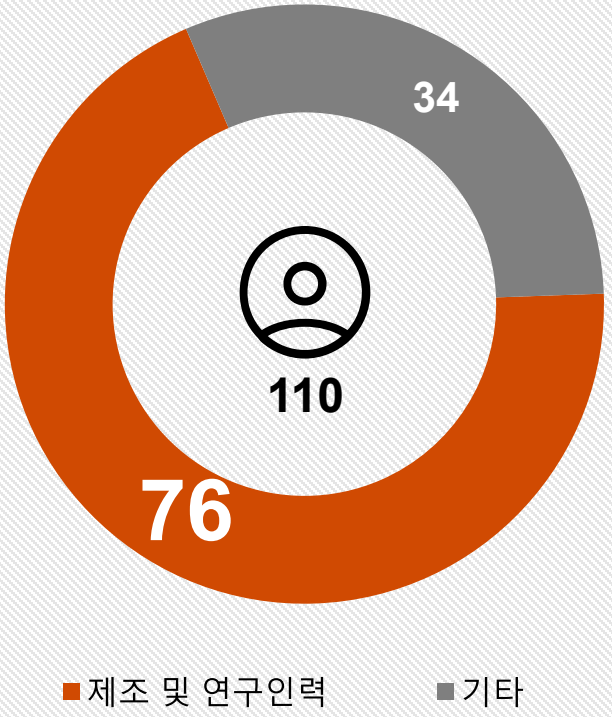
회사 개요

회사명	브이엠 주식회사(VM, Inc)
대표자	최우형 / 임종필
설립일	2002–02–22
본사 소재지	경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47
임직원 / 특허 수(*)	110명 / 95개 (해외 48개 포함)
매출/영업이익/세전손익	1,612억 / 502억 / 577억 (**)

최우형 대표이사 약력

학력	고려대학교 경영학과
주요 경력	KB인베스트먼트 투자담당 이사
	미래산업, 바이오스페이스, 인텍플러스, 테라세미콘 등 투자 및 사후관리
	KoFc-KB 청년창업펀드 펀드매니저
	現 VM㈜ 대표이사 (2018.11 ~ 현재)

핵심 인력 구성 비율



(*) 2026년 10월말 현재

(**) 2026년 06월말 현재, 연결재무제표

02

연혁

2002
회사설립

2005
200mm Metal etcher 판매

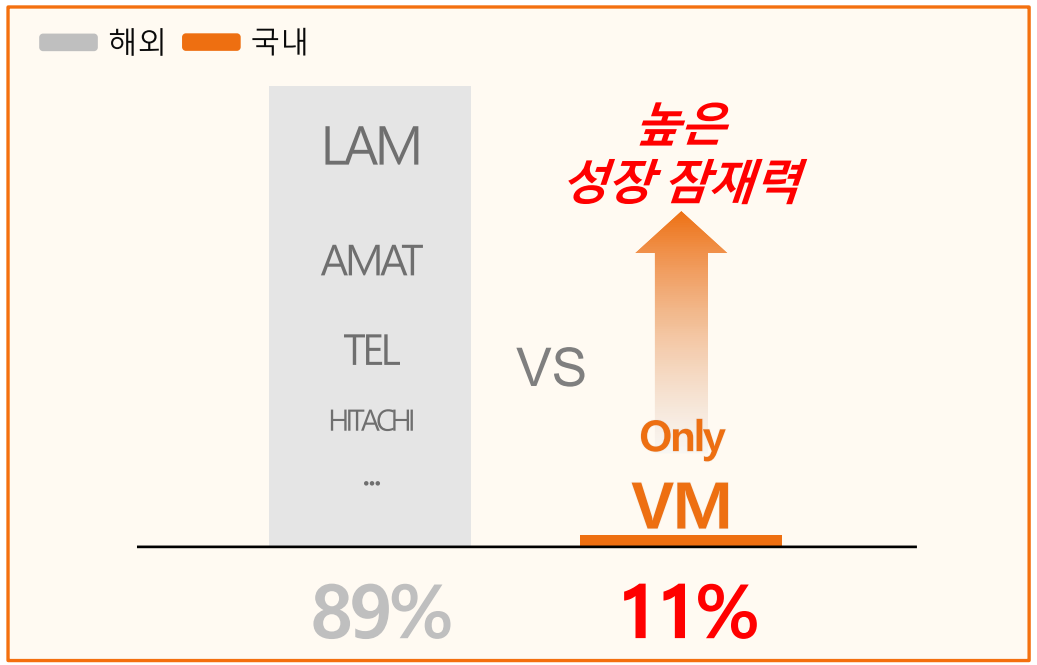
2007
반도체 기술대상 국무총리상 수상

2013
300mm Poly etcher 판매

2018
코스닥 상장

2021, 22
제13, 14회 코스닥 대상 '최우수4차산업혁신기업상(21)'
'ESG기업상(22)'

2024
사명변경
(APTC ▶ **VM**)



신뢰기반 Relationship에 따른 **Base Line 공급 안정성**
& 공정 점유율 확대에 따른 **높은 성장성** 동시 보유

03

주요 실적 및 전망

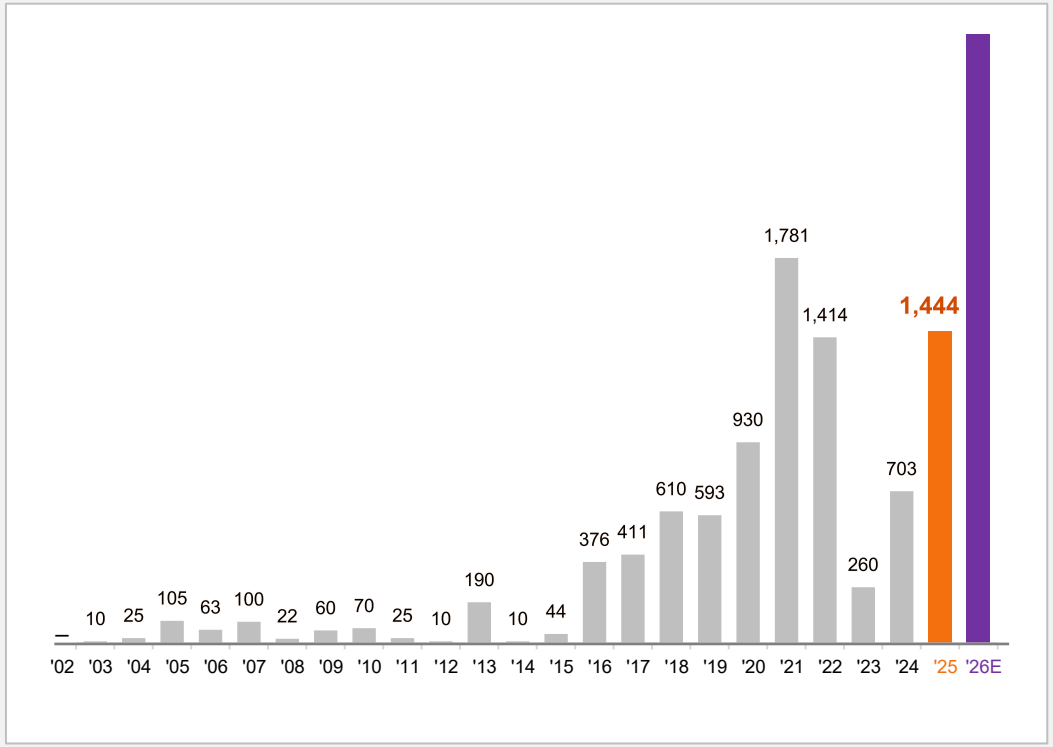
최근 3개년 재무현황 및 전망

(연결 재무제표, 단위 : 억원)

구분	'22.12	'23.12	'24.12	'25.12	'26.06
매출액	1,414	260	703	1,444	1,612
-제품	1,198	98	548	1,143	1,446
-상품	216	162	155	301	166
영업손익	309	(110)	(86)	247	502
세전손익	351	(73)	(46)	273	577

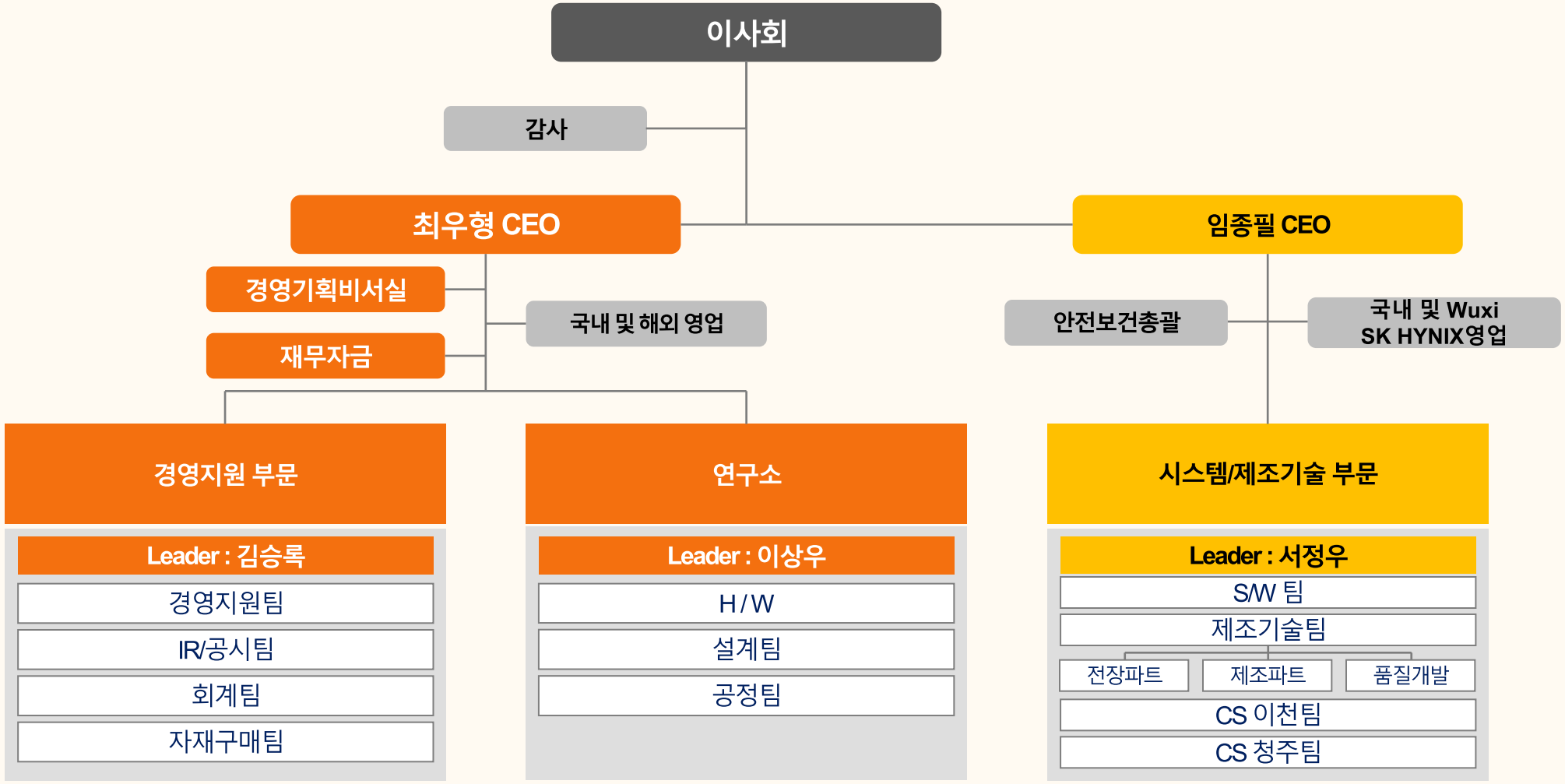
과거 매출 추이 및 전망

(연결재무제표, 단위 : 억원)



04

주요 조직 현황


이사회
감사
최우형 CEO
임종필 CEO
경영기획비서실
재무자금
국내 및 해외 영업
안전보건총괄
국내 및 Wuxi
SK HYNIX영업
경영지원 부문
연구소
시스템/제조기술 부문
Leader : 김승록
경영지원팀
IR/공시팀
회계팀
자재구매팀
Leader : 이상우
H/W
설계팀
공정팀
Leader : 서정우
S/W 팀
제조기술팀
전장파트
제조파트
품질개발
CS 이천팀
CS 청주팀

CONTENTS

VM Investor Relations 2026

01 회사 소개

02 Our Business

03 Our Strength

04 Our Strategy

01 반도체 시장의 기업가치

반도체 기업

회사명	시가총액
SK하이닉스	$809B (14,082,999억원)
마이크론	$842B (1,286조 4,600억원)
삼성전자	$1T (1,286조 4,600억원)
AMD	$742B (1,087조 7,743억원)
Broadcom	$2T (2,953조 6,495억원)

반도체 장비 기업

회사명	시가총액
Lam Research	$367B (538조 1,598억원)
Applied Materials	$345B (509조 1,320억원)
TEL	$150B (226조 6,901억원)
VM	$0.9B (1조 4,393억원)

반도체 부품 기업

회사명	시가총액
Advanced Energy	$13.5B (19조 2,076억원)
MKS	$21B (31조 3,507억원)

*기준 시점 : 2026.5.13.

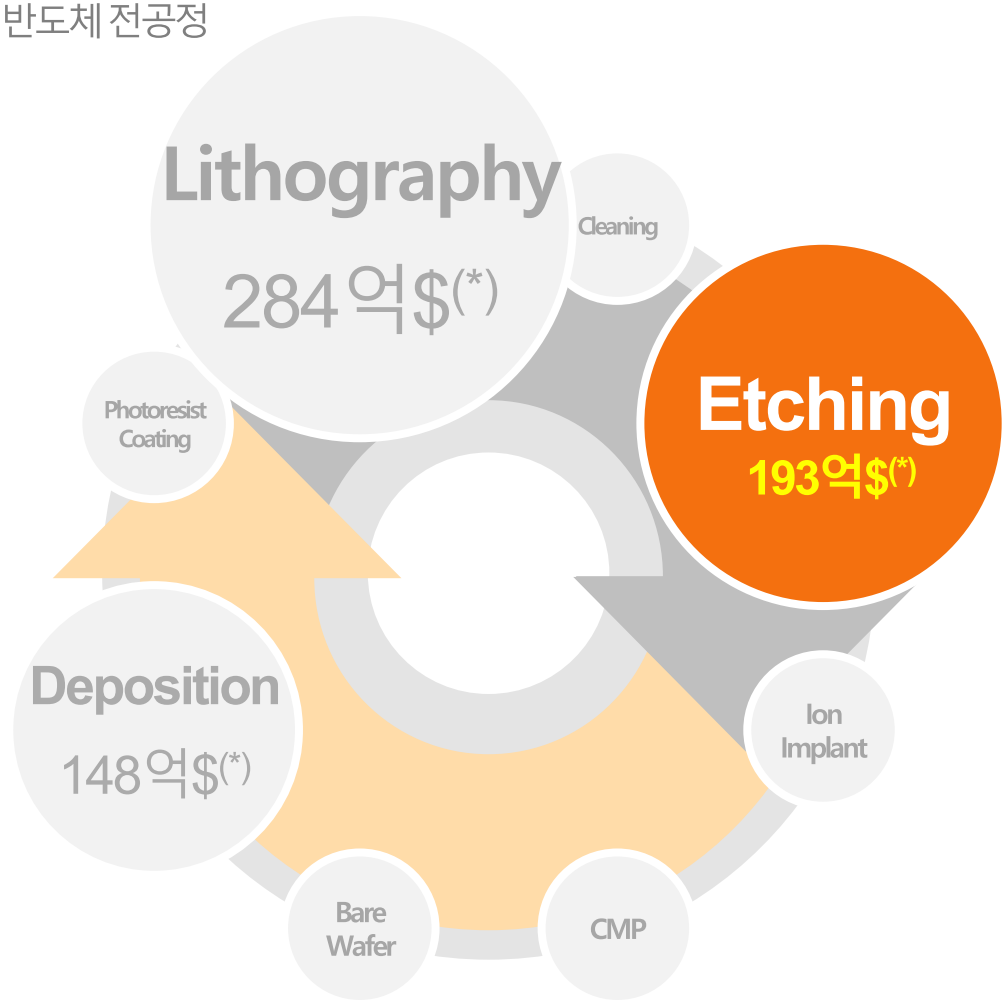
02

식각 (Etching) 공정이란?

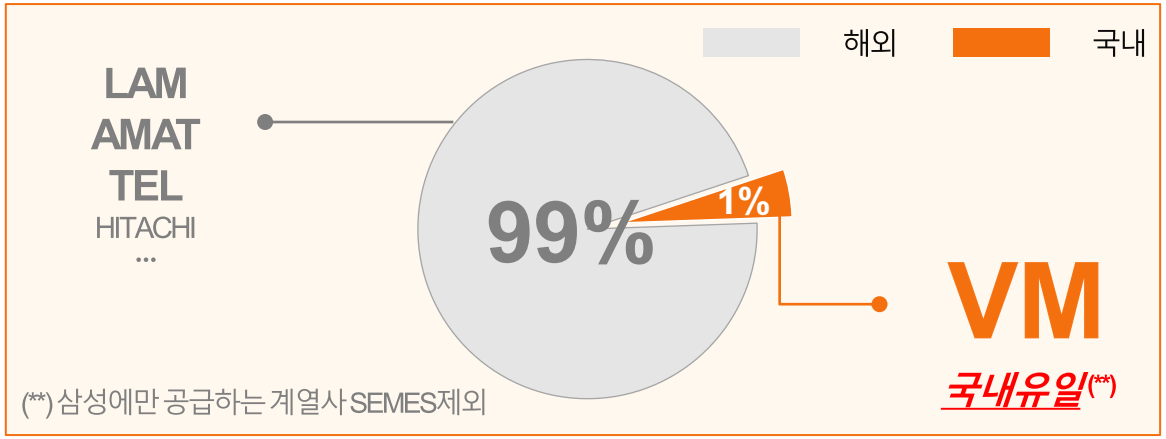
노광 & 증착공정과 함께 **반도체**의 **3대 핵심 공정** (총 8공정) 중의 한 공정이며, **국내**의 글로벌 식각장비 기술 업체는 **VM**이 **유일**

Gartner WFE Capacity_3Q25

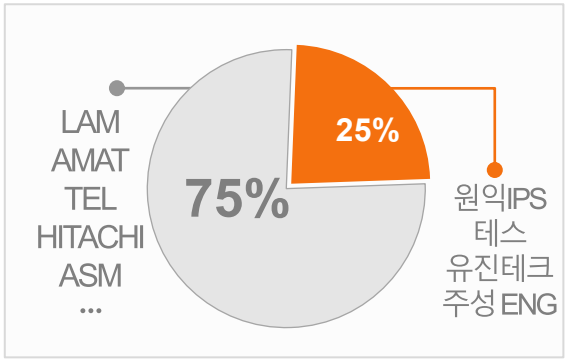
※반도체 전공정



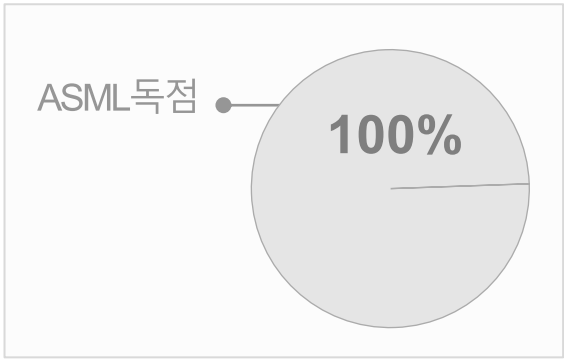
※ Etching 장비 글로벌시장점유율



※ Deposition

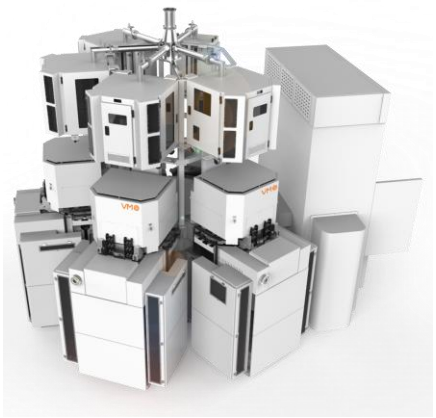


※ Lithography_(EUV ARF 기준)



(*) Gartner 2025년 시장규모 연간 추정치 (첨부 워크시트 참조)

03 주요 제품 소개

구 분	Model		Status	Device	특장점
POLY ETCHER		Leo NK I-C	양산	DRAM	**최초(2016년) 양산 성공** 장비 (지속적으로 공급 중)
				NAND	
		Leo WH	양산	DRAM	**HBM 공정用 주력 장비**
				NAND	
		Leo WS	DEMO TEST	DRAM	고객사 차세대 Device 맞춤형 장비 **현재 양산 TEST 진행 중**
				NAND	
METAL ETCHER		Nardo M	양산	DRAM	**경쟁사 대비 동급 최고 성능 고객사 독점 공급**
				NAND	
OXIDE ETCHER		Mona LISA	Developing	DRAM	**2026년 內 개발완료** 및 양산 TEST **예정**
				NAND	
ALE		APES A	Developing	DRAM	차세대 메모리 시장 用
				NAND	

CONTENTS

VM Investor Relations 2026

01 회사소개

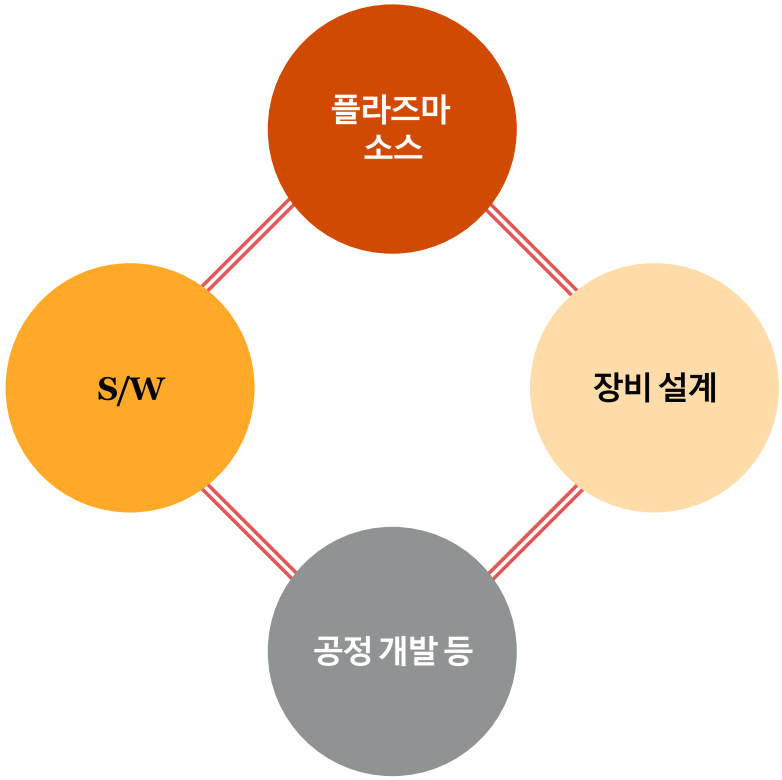
02 Our Business

03 Our Strength

05 Our Strategy

01 차별화된 기술력

차별화된 **플라즈마 소스 원천 기술**을 통한 **글로벌 기술경쟁력** 보유



'26.11 특허 등록 현황

국내	47
해외	48
합계	95

상세 년도별 특허 등록 추이

구분	'07	'08	'11	'12	'13	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26.11	합계
국내	2	3	4	1	3	2	2	3	1	3	3	-	4	1	10	3	2	*47*
해외	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	8	18	11	*48*
합계	2	3	4	1	3	2	2	3	1	3	4	2	8	5	18	21	13	*95*

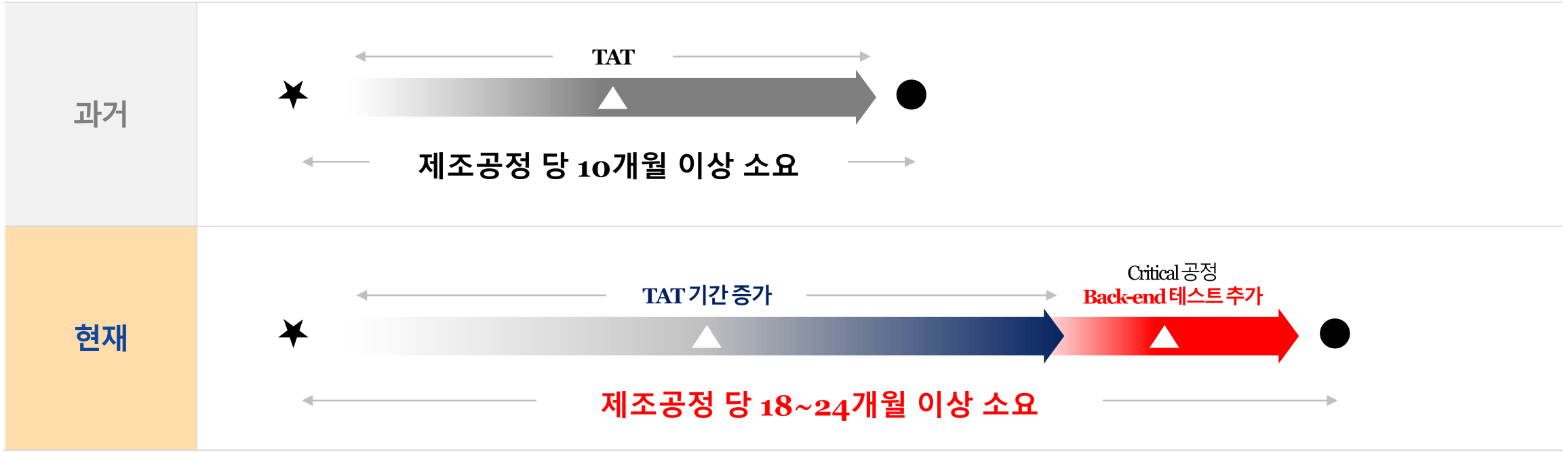
Our Strength

02 높은 진입장벽

공정의 **미세화** ▶ **점점 더 까다로운** Qualification ▶ 기존 검증 업체 外 **신규업체 진입 거의 불가**

※ "H"사 Qualification 공정 TEST Process (예시)

★ 공정착수 ▲ 퀄 테스트 ● TEST완료



(*)TAT : Turn Around Time, 웨이퍼가 모든 공정을 거쳐 최종적으로 반도체 칩이 되어 공장을 빠져나오는 데까지 걸리는 총 소요 시간

(*)Back-end Test : 완성된 반도체 칩이 정상적으로 작동하는지, 그리고 제품의 기능과 성능이 규격에 맞는지 여부에 대한 최종 검사

CONTENTS

VM Investor Relations 2026

01 회사소개

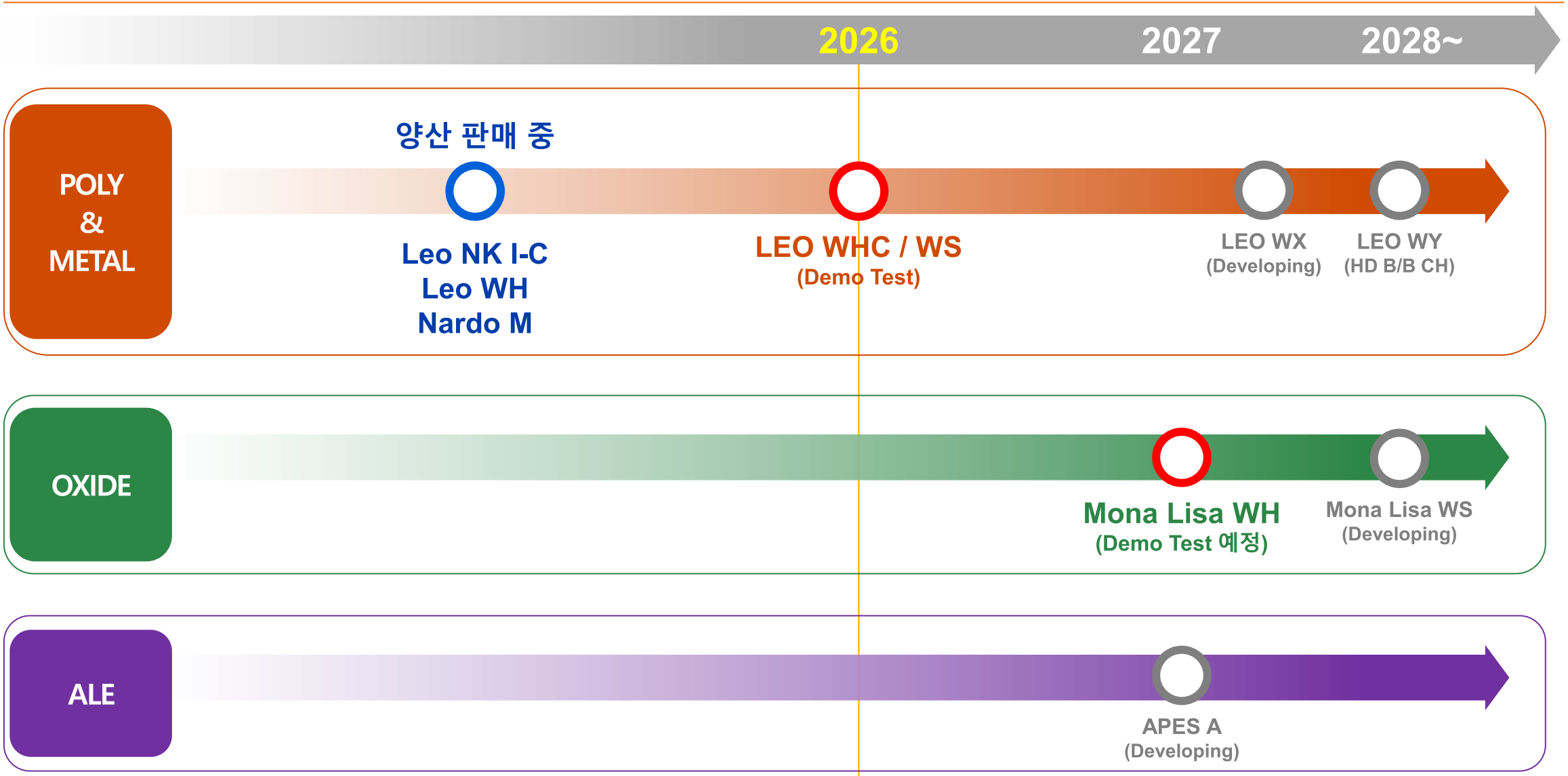
02 Our Business

03 Our Strength

04 Our Strategy

01

제품 개발 Roadmap



02

글로벌 진출 Roadmap

Global VM within *2 Years*

Benefits with VM

Technical Support & Process Optimization

기술 지원과 공정 개발 全 과정에 대한 긴밀한 협응 역량 보유



New alternative

글로벌 건식 식각시장의 새로운 대안(New Partner)

Lower TCO

타사 대비 TCO 절감을 통한 수익성 극대화

Our Goal

SK hynix

Micron

tsmc

SAMSUNG 삼성전자

03 CAPEX

용인 반도체 클러스터 본사 이전 조감도



소재지	용인 원삼면 **반도체 클러스터**
규모	토지 2,576평 건폐율 70%(1,803평) 용적률 280%(**7,212평**)
소요 예산	**약 800억~1,000억**
준공시기	**'28년** 중 (예상)

감사합니다.